

<b>INFATEC</b>	<b>System INFATEC</b>		
	<b>MONTAŻ SYSTEMU INFATEC</b>	Wydanie: <b>2/2007</b> Data: <b>31.10.2007.</b>	Strona 1 z 4

## I. PODŁOŻE

1. Podłoże do którego przyklejane są płyty INFATEC P powinno być stabilne, nośne, suche i czyste – pozbawione elementów zmniejszających przyczepność kleju takich jak kurz, pył, olej szalunkowy, łuszczące się warstwy farby, pylący stary tynk itp.
2. Poniżej przedstawione są niektóre sposoby przygotowania podłoża

Rodzaj defektu podłoża	Czynność przygotowawcza
Kurz, pył	Oczyszczyć za pomocą szczotki, sprężonego powietrza lub wodą pod ciśnieniem
Luźne resztki lub nadmiar zaprawy w spoinach	Skuć i oczyścić
Nierówności, ubytki	Skuć, wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z zastosowaniem zaleceń producentów zapraw
Brud, sadza, tłuszcz	Zmyć wodą pod ciśnieniem, z ewentualnym dodatkiem środków czyszczących, spłukać czystą wodą
Mleczko cementowe na elementach betonowych	Zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem
Środki antyadhezyjne	Zmyć wodą pod ciśnieniem, z ewentualnym dodatkiem środków czyszczących, spłukać czystą wodą
Łuszczące farby	Usunąć mechanicznie, za pomocą środków chemicznych lub wodą pod ciśnieniem
Nadmiernie nasiąkliwe podłoże (pyłące, osypujące się)	Zastosować odpowiedni preparat gruntujący (grunt głębok penetrujący) zgodnie z instrukcją producenta

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić próbę. W kilku miejscach podłoża przykleić próbki płyty INFATEC P o wymiarach ok. 10x10 cm. Po ok. 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania. Przyjmuje się, że podłoże jest odpowiednio przygotowane, jeżeli podczas ręcznego odrywania nastąpi rozwarstwienie płyty (część płyty pozostanie przyklejona do podłoża).

3. Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyień powierzchni i krawędzi. Nie dopuszczalne jest wyrównywanie podłoża za pomocą grubszej warstwy zaprawy klejowej albo podkładania materiału izolacyjnego. W tabeli poniżej podane są normatywne odchylenia dla przykładowych rodzajów podłoża

Odchyłka	Z cegły i pustaków ceramicznych mury spoinowane	Z betonu komórkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów na długości 1 m	3 mm	4 mm
Odchylenia od pionu powierzchni krawędzi na całej wysokości ściany	20 mm	15 mm
Odchylenia powierzchni muru od zaprojektowanego kąta	3 mm	10 mm

INFATEC	<b>System INFATEC</b>		
	<b>MONTAŻ SYSTEMU INFATEC</b>	Wydanie: <b>2/2007</b>	Strona 2 z 4
		Data: <b>31.10.2007.</b>	

## II. MOCOWANIE LISTWY STARTOWEJ

1. Szerokość listwy startowej odpowiada grubości płyty montażowej INFATEC P, powiększonej o 20 mm. (miejsce na kształtkę klinkierową)
2. W narożu listwę startową należy przyciąć pod kątem 45° i połączyć z podobnie przyciętą listwą ściany sąsiedniej.
3. Poszczególne listwy należy łączyć ze sobą za pomocą łączników, aby zachować jednakowy poziom. (zalecamy łączniki Koelner LPC)

## III. PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJĄCEJ INFATEC K

Zaprawę klejącą INFATEC K przygotowuje się zgodnie z kartą katalogową produktu. Należy zwracać uwagę na:

- ilość wody zarobowej, która nie powinna przekraczać podanej w instrukcji (w proporcji 5,50 ÷ 6,25 l na 25 kg suchej mieszanki)
- ponowne przemieszanie zaprawy po ok 5 minutach od pierwszego mieszania (jest to tzw czas dojrzewania zaprawy)
- wykorzystanie przygotowanej zaprawy w ciągu 4 godzin (czas gotowości zaprawy do pracy). Niedopuszczalne jest dolewanie wody do zaprawy i wykorzystywanie jej po czasie gotowości do pracy.

## IV. PRZYGOTOWANIE PŁYT MONTAŻOWYCH INFATEC P

1. Przed montażem należy przygotować odpowiednią ilość połówek płyt montażowych INFATEC P, tak aby można było wykonać elewację zgodnie z zasadą „wiązania” płyt.
2. Płyty montowane w narożniku należy przyciąć pod kątem 45
3. Przy montowaniu pierwszej warstwy płyt montażowych INFATEC P odciąć pierwszą prowadnicę poziomą na wysokości jej górnej krawędzi.
4. Do cięcia płyt zaleca się stosować urządzenia elektrooporowe, które dają równą i gładką powierzchnię cięcia.

## V. KLEJENIE PŁYT INFATEC P

1. Zaprawę klejową na płytę nakłada się metodą obwodowo-punktową. Po obwodzie płyty nakładamy pasmo kleju o szerokości min 3 cm, oraz w środku płyty nakładamy 3 do 6 placków kleju. Po dociśnięciu płyty do podłoża minimum 60% powierzchni płyty powinno być pokryte zaprawą klejową.
2. Przy równych i gładkich podłożach dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty, tak by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 4-10 mm.
3. Zaprawę klejącą nakłada się tylko na płyty INFATEC P, nigdy na podłoże!
4. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej należy przyłożyć płytę INFATEC P do podłoża i docisnąć równomierne np za pomocą drewnianej pacy o dużej powierzchni. Nie wolno używać młotków, które mogą prowadzić do uszkodzenia płyty.
5. Prawidłowy kierunek montażu wyznacza logo „INFATEC” na płycie, które powinno się znajdować zawsze w lewym górnym rogu płyty. Takie ułożenie zapewnia prawidłowe ustawienie wpustu płyty INFATEC P. Dzięki temu nie ma możliwości przedostawania się wody pomiędzy płyty montażowe.

INFATEC	<b>System INFATEC</b>		
	<b>MONTAŻ SYSTEMU INFATEC</b>	Wydanie: <b>2/2007</b> Data: <b>31.10.2007.</b>	Strona 3 z 4

6. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania można sprawdzić po związaniu kleju przez ucisk naroży – nie powinno następować ich ugięcie.
7. Zaprawa klejowa nie może się przedostawać na boczne krawędzie płyty. Jej nadmiar należy usunąć. Płyty powinny być dokładnie dociśnięte do siebie. Pozostawienie zaprawy w spoinach powoduje powstawanie mostków termicznych.

## VI. MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH INFATEC D

1. Łączniki mechaniczne INFATEC D z trzpieniem stalowym montuje się po minimum 2 dniach od przyklejenia płyt, po związaniu zaprawy klejowej.
2. Łączniki w ilości do 9 szt/m<sup>2</sup> osadza się wykorzystując zagłębienia w płycie montażowej.
3. Do wiercenia otworów w betonie należy stosować wiertarki udarowe. Do wiercenia otworów w materiałach porowatych (cegła dziurawka, pustak szczelinowy, beton komórkowy) nie wolno stosować udaru! W przeciwnym wypadku zostanie zniszczona struktura materiału i łącznik nie będzie zakotwiony wystarczająco mocno
4. Nie wolno zastępować łączników INFATEC D innymi łącznikami np. z trzpieniem tworzywowym i mniejszej nośności!
5. Wymagana długość łącznika w zależności od grubości płyty izolacyjnej INFATEC P:

Grubość płyty INFATEC P	Niezbędna długość łącznika INFATEC P
80 mm	130 mm
100 mm	150 mm
120 mm	170 mm
140 mm	190 mm

## VII. KLEJENIE KSZTAŁTEK KLINKIEROWYCH

1. Kształtki klinkierowe klei się również za pomocą zaprawy klejącej INFATEC K.
2. Zaprawę klejową INFATEC K nanosi się na płytę montażową INFATEC P pomiędzy prowadnicami poziomymi (tzw powierzchnia klejenia) za pomocą pacy zębatej (zęby 2-3 mm)
3. Na kształtkę klinkierową również nanosi się cienką warstwę zaprawy.
4. Kształtkę umieszczamy pomiędzy prowadnicami, dociskając oraz poruszając ruchem poprzecznym, tak aby klej wypełnił dokładnie przestrzeń pod kształtką.
5. Dopuszczalne jest nakładanie zaprawy klejowej na samą kształtkę klinkierową, następnie kształtkę dociska się do powierzchni klejenia, tak aby klej wypełnił przestrzeń pod kształtką.
6. Pomiedzy kolejnymi kształtkami należy zachować odstęp ok 15 mm (szerokość spoiny). Należy na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej.
7. Zaprawa klejąca zachowuje swoje właściwości przez ok 30 minut po nałożeniu na płytę. Dlatego nie należy nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię.
8. Klejenie kształtek zaleca się zaczynać od kształtek narożnikowych.

INFATEC	<b>System INFATEC</b>		
	<b>MONTAŻ SYSTEMU INFATEC</b>	Wydanie: <b>2/2007</b> Data: <b>31.10.2007.</b>	Strona 4 z 4

## VIII SPOINOWANIE

1. Do spoinowania (fugowania) wykorzystuje się gotową masę fugową INFATEC F
2. Zaprawę fugową INFATEC K przygotowuje się zgodnie z kartą katalogową produktu.
3. Konsystencja zaprawy powinna być półsucha. Dlatego nie należy przekraczać podanej w instrukcji ilości wody zarobowej (ok 2,5 l na 25 kg suche zaprawy do spoinowania).
4. Krawędzie boczne przyklejonych kształtek nie mogą być zabrudzone zaprawą klejową INFATEC K.
5. Masę fugową nakłada się za pomocą kielni do spoin tzw „fugówki” zaczynając od góry elewacji.
6. Masa fugowa musi wypełniać spoiny całkowicie (licować się z powierzchnią kształtki) tzw fugowanie na „pełne spoiny”. Zastosowanie cieńszych spoin nie gwarantuje utrzymania jakości systemu INFATEC.
7. Nadmiar masy fugowej usunąć z kształtek za pomocą szczotki lub pędzla ławkowca.

## IX. RYSUNKI

Z pomocnymi podczas projektowania i montażu rysunkami można się zapoznać (i pobrać) na stronie internetowej: [www.infatec.pl](http://www.infatec.pl) zakładka: Infatec Architektura: [www.infatec.pl/infatec\\_architekta.html](http://www.infatec.pl/infatec_architekta.html)

## X. UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

**Tylko dokładne stosowanie się do wytycznych montażu systemu INFATEC zapewnia trwałość systemu oraz bezpieczeństwo użytkownika.**

Ciężar 1 m<sup>2</sup> elewacji w systemie INFATEC przy grubości płyty INFATEC P 10 cm to około 45 kg.

Material	Przybliżony ciężar: [kg/m <sup>2</sup> ]
Klej INFATEC K (klejenie płyty)	4
Płyta montażowa INFATEC P	3
Klej INFATEC K (klejenie kształtek)	4
Kształtka klinkierowa	28
Zaprawa fugowa INFATEC F (szerokość fugi 15 mm)	6
<b>Razem:</b>	<b>45</b>

Awaria systemu INFATEC spowodowana nieprawidłowym montażem może spowodować w skrajnym wypadku (źle przygotowane, nienośne podłoże oraz wadliwie osadzone łączniki) odpadnięcie elewacji od podłoża. Ciężar 45 kg może wyrządzić poważne szkody materialne, oraz zagrozić życiu i zdrowiu osób przypadkiem przechodzących.

Producentem systemu INFATEC jest:

„Jacob” Sp z o.o.  
Ul. Ks. bpa Bogedaina 2  
40-749 Katowice  
tel: 0-32/205-51-13  
fax: 0-32/205-51-14  
[www.infatec.pl](http://www.infatec.pl)  
[infatec@infatec.pl](mailto:infatec@infatec.pl)

Pytania techniczne dotyczące systemu należy kierować na adres: [infatec@infatec.pl](mailto:infatec@infatec.pl)